



股票简称:闻泰科技 股票代码:600745

闻泰科技股份有限公司

WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD

(注册地址:黄石市团城山6号小区)

公开发行可转换公司债券上市公告书

保荐机构(主承销商)



(注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

二〇二一年八月

第一节 重要声明与提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项,并认真阅读本募集说明书摘要风险因素等相关章节。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“闻泰科技”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机构对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2021年7月26日刊载于《中国证券报》的《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(摘要)》及刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的募集说明书全文。

本上市公告书使用的简称释义与《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。

第二节 概览

- 一、可转换公司债券简称:闻泰转债(上市首日简称:N闻泰债)
- 二、可转换公司债券代码:110081
- 三、可转换公司债券发行量:860,000.00万元(8,600万张,860万手)
- 四、可转换公司债券上市量:860,000.00万元(8,600万张,860万手)
- 五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
- 六、可转换公司债券上市时间:2021年8月20日
- 七、可转换公司债券存续的起止日期:自2021年7月28日至2027年7月27日
- 八、可转换公司债券转股的起止日期:自2022年2月3日至2027年7月27日
- 九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
- 十、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转股的公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
- 十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 十二、托管方式:账户托管
- 十三、登记公司托管量:860,000.00万元
- 十四、保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司
- 十五、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债不提供担保
- 十六、可转换公司债券信用评级及资信评估机构:公司主体信用评级为AA+,本次可转债的信用评级为AA+,评级机构为中证国际信用评级有限责任公司

第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2338号)核准,公司于2021年7月28日公开发行了8,600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额86.00亿元。

本次发行的闻泰转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,向原A股股东优先配售的比例为本次发行规模的55.67%,原A股股东优先配售后备余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。认购不足4,231.60万元的余额由华泰联合证券进行包销。

经上海证券交易所自律监管决定书(2021)356号文同意,公司860,000.00万元可转换公司债券将于2021年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“闻泰转债”,债券代码“110081”。

本次公开发行的《募集说明书摘要》已刊登于2021年7月26日的《中国证券报》。《募集说明书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

第四节 发行人概况

一、公司基本情况
 中文名称:闻泰科技股份有限公司
 英文名称:WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD
 注册资本:1,244,937,731元
 法定代表人:张学政
 股票上市交易所:上海证券交易所
 股票简称:闻泰科技
 股票代码:600745
 注册地址:黄石市团城山6号小区
 成立日期:1993-01-11
 邮政编码:435003
 公司网址:http://www.wingtech.com/cn
 电子邮箱:600745mail@wingtech.com
 电话号码:0573-82582899
 传真号码:0573-82582880

经营范围:一般项目:智能机器人的研发;数字文化创意软件开发;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;可穿戴智能设备制造;网络设备制造;通信设备制造;移动通信设备制造;移动终端设备制造;显示器制造;智能家庭消费设备制造;数字家庭产品制造;智能车载设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;电子产品制造;电子专用材料制造;物业管理;酒店管理;电子产品销售;网络设备销售;智能家庭消费设备销售;软件销售;智能无人飞行器销售;智能车载设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;服装服饰设备销售;可穿戴智能设备销售;针织纺织品及原料制造;服装服饰零件;服装服饰销售;金属材料销售;建筑材料销售;电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子元件批发;电子产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

二、公司的历史沿革

(一)设立及发行上市前的股本结构
 闻泰科技股份有限公司的前身为“黄石服装股份有限公司”、“黄石康赛股份有限公司”,公司1996年8月在上海证券交易所上市前的曾用名还包括“黄石康赛时装股份有限公司”、“黄石康赛股份有限公司”。
 1990年4月,经湖北省体改办以鄂改[1990]4号文件,黄石市人民政府以黄改[1990]10号文件和中国工商银行湖北省分行鄂改[1990]121号文件批准,由黄石服装厂独家发起,以其南湖厂厂全部资产折股135万股(面值1.00元,下同)和募集社会个人股165万股而设立黄石服装股份有限公司,公司总股本为3300万股。

1996年8月,经中国证监会证监发字[1996]第158号文件批准,上海证券交易所以上证上字[1996]第069号文同意,公司股票于1996年8月28日在上海证券交易所挂牌交易。股票简称:康赛集团,股票代码:600745。

(二)发行上市后股本变动情况

1、1997年公司送股及资本公积转增股本
 1997年4月,经公司股东大会审议通过,以1996年年末股本总额5,279.16万股实施1995年度按10:2的比例送股和1996年度按10:6的比例送股及按10:2的比例由资本公积转增股本,本次股份转送后股本总额为10,558.32万股。
 2、1998年公司配股
 1998年7月,经中国证券监督管理委员会[1998]79号文件批准,公司以1997年末股本总额10,558.32万股为基数,按10:3的比例向全体股东配售,配售股份1,616.1696万股,本次股份配售后公司股本总额为12,174.4896万股。
 1999年5月,公司名称更名为黄石康赛股份有限公司。
 2003年3月,公司名称更名为湖北天华股份有限公司。
 3、2007年公司股权转让——实际控制人变更
 2007年4月26日,公司股东河南戴克实业有限公司将其所持有的公司股份2,050万股中的1,537.5万股、上海晋乾工贸有限公司将其持有的本公司股份746万股中的529.66万股、上海聿达投资咨询有限公司和上海步欣工贸有限公司分别将其持有的本公司股份607.74万股中的430.97万股共同转让给苏州中茵集团有限公司,上述股权已于2007年5月8日完成过户。本次股权转让完成后,控股股东由河南戴克实业有限公司变更为中茵集团,中茵集团共持有公司2,929.10万股股票,占公司总股本的24.06%。实际控制人由庄凯变更为高建荣,高建荣通过中茵集团间接持有公司1,757.46万股股票,占公司总股本的14.436%。
 4、2008年公司股权分置改革及发行股份购买资产
 2008年1月2日,公司召开股权分置改革相关股东大会会议,通过了《湖北天华股份有限公司关于公司股权分置改革方案的议案》,股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有10流通股将获得获得股票1.447股,

非流通股股东对流通股股东共支付676.8万股补偿对价。

2007年9月27日,公司与中茵集团签署了《新增股份购买资产协议》,以2.67元/股的价格向中茵集团新增发行20,563万股股票,用于购买中茵集团持有的江苏中茵置业有限公司(以下简称“江苏中茵”)100%的股权、连云港中茵房地产有限公司(以下简称“连云港中茵”)70%的股权和昆山泰莱建筑屋有限公司(以下简称“昆山泰莱”)60%的股权。2008年4月18日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北天华股份有限公司向苏州中茵集团有限公司定向发行股份购买资产等资产重组行为的批复》(证监许可[2008]506号),核准公司向中茵集团发行20,563万股的人民币普通股购买相关资产,增发后,公司股本达到32,737.4896万股。上述置入资产已于2008年4月22日全部过户完毕,公司新增20,563万股份于2008年4月29日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。
 5、2014年公司非公开发行股票
 2014年4月18日,中国证监会向公司核发《关于核准中茵股份有限公司非公开发行股票的意见》(证监许可[2014]432号),核准公司非公开发行不超过18,000万股新股。2014年9月,公司向永赢基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、融通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、招商基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、上海基金管理有限责任公司、招商基金管理有限公司等6家特定对象非公开发行155,945,454股股份。本次发行前公司股本总额为327,374,896股,发行后股本总额为483,320,350股,实际控股人不变,仍为高建荣。

6、2015年公司发行股份购买资产

2015年12月,根据公司2015年6月17日第三次临时股东大会决议审议通过的《关于中国股份发行股份购买资产的议案》,并于2015年9月30日经中国证券监督管理委员会《关于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]2227号)核准,公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司非公开发行人民币普通股购买闻天下所持有的闻泰通讯股份有限公司51%股权,共发行153,946,037股,增发后公司股本为637,266,387股。

7、2019年公司发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证监会《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]112号)核准,公司于2019年10月30日向云南省城投、西藏风格、西藏富汇、鹏欣智游、上海砂矿、国联集成电路、格力电器、智泽兆纬、珠海融林、德信盛弘合计发行403,400,589股用于收购上述交易对方持有的标的资产,于2019年12月18日向工银瑞信基金管理有限公司等10名投资者合计发行83,366,733股用于募集重组配套资金。上述增发完成后,上市公司总股本为1,124,033,709股。

8、2020年7月公司实施股票激励计划

根据《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划》,闻泰科技于2020年7月16日完成限制性股票的权益登记工作,新增有限售条件流通股7,941,695股。本次限制性股票权益登记完成后,上市公司总股本变更为1,131,975,404股。

9、2020年公司发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证监会《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]1171号)批准,闻泰科技于2020年7月27日向合肥芯屏等6名交易对方发行68,381,236股股份购买其持有的安世集团上层标的资产,并向枣庄铁投投资合伙企业(有限合伙)等16名投资者发行44,581,091股股份用于募集配套资金。本次发行股份购买资产及募集配套资金完成后,上市公司总股本变更为1,244,937,731股。

10、2021年3月公司股票激励计划预留部分授予完成

根据公司于2021年3月9日披露的《2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益授予完成的公告》,闻泰科技于2021年3月5日完成授予限制性股票的权益登记,新增有限售条件流通股141,331股。本次限制性股票权益登记完成后,上市公司总股本变更为1,245,079,062股。截至本上市公告书出具日,上述股本变更相关的工商变更登记手续尚未完成。

11、2021年7月公司2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票

2021年7月7日,公司召开了第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意对部分激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权1,240,622份进行注销,并对其所持有的已获授但未解除限售的限制性股票49,389股进行回购注销。截至本上市公告书出具日,上述注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项尚未实施完毕,股本变更相关的工商变更登记手续尚未完成。

三、公司股本结构及前十名股东持股情况

(一)本次发行前公司的股本结构

截至2020年12月31日,公司股本结构如下:

股份类别	持股数量	持股比例
一、有限售条件股份	425,326,541	34.16%
1.国有法人持股	5,611,067	0.46%
2.其他内资持股	419,715,474	33.70%
其中:境内法人持股	284,284,767	22.84%
境内自然人持股	19,349,300	1.56%
3.境外持股	5,996,307	0.48%
其中:境外法人持股	5,996,307	0.48%
二、无限售条件股份	819,701,188	65.84%
1.人民币普通股	819,701,188	65.84%
三、优先股	1,244,937,731	100.00%

(二)本次发行前公司前10大股东持股情况

截至2020年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
1	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	12.27%	153,946,037	0	质押
2	无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)	9.76%	121,556,915	121,556,915	无
3	天津广联国际资本投资合伙企业(有限合伙)	7.42%	92,420,040	92,420,040	无
4	云南国联集成电路投资中心(有限合伙)	6.49%	80,736,418	0	质押
5	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	5.07%	70,576,158	0	质押
6	合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	3.27%	53,968,588	53,968,588	无
7	智泽兆纬	2.97%	37,800,000	0	无
8	珠海融林	2.88%	36,358,996	36,358,996	无
9	香港中芯投资有限公司	1.96%	24,360,661	0	无
10	闻泰通讯股份有限公司	1.86%	20,983,047	14,181,524	质押
	合计	55.53%	691,266,887	317,976,000	质押

注:上述股东中,拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司与张学政为一致行动人,珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)与珠海格力电器股份有限公司为一致行动人。

四、公司的主营业务

(一)主要业务与产品

发行人主营业务为通讯终端产品的研发和制造业、半导体和新型电子元器件的研发和制造业,包括移动终端和半导体两大业务板块,目前已经形成从半导体产品设计、晶圆制造、半导体封装测试到通讯终端、笔记本电脑、IoT、智能硬件、汽车电子等产品制造于一体的产业布局。
 发行人移动终端板块主要从事移动终端、智能硬件、笔记本电脑、虚拟现实、车联网、汽车电子等物联网领域产品的研发和制造,公司拥有中国领先的移动终端和智能硬件产业生态平台,是全球手机出货量最大的ODM龙头公司,2019年手机ODM出货量约占中国手机ODM厂商总出货量的1/3。公司移动终端板块客户包括众多国内外知名厂商。研发中心分布在上海、无锡、深圳、西安等地,制造基地分布在嘉兴、无锡、昆明、印度和印尼。
 发行人半导体板块主要由全资子公司安世集团运营。安世集团是全球知名的半导体IDM公司,前身是恩智浦的标准产品事业部,拥有60多年的半导体行业专业经验,于2017年初开始独立运营。安世集团分立器、逻辑器件、MOSFET器件的主要产品市场占有领先地位,位居全球前三名。目前安世集团在英国和德国拥有前端晶圆加工工厂,在中国广东、马来西亚、菲律宾分别拥有一座后端封测工厂,并在荷兰拥有一座工业设备研发中心ITTEC,销售网络覆盖全球主要地区。

(二)公司行业地位

1、移动终端板块

发行人移动终端板块主要从事移动终端、智能硬件、笔记本电脑、虚拟现实、车联网、汽车电子等物联网领域产品的研发和制造,拥有中国领先的移动终端和智能硬件产业生态平台。公司移动终端板块客户包括众多国内外知名厂商。

2、半导体板块

公司半导体业务在英国和德国拥有前端晶圆加工工厂,在中国广东、马来西亚、菲律宾分别拥有一座后端封测工厂,并在荷兰拥有一座工业设备研发中心ITTEC,销售网络覆盖全球主要地区。

3、持续开拓行业全球市场

移动终端板块,客户客户群遍及全球各地,与行业大多数主流品牌保持着深度的合作关系,服务全球170多个国家和地区。公司在2019年开始开拓海外市场,目前已在北美市场布局,打造全球交付体系并在海外建设生产基地,是行业少有的能满足北美运营商高标准的ODM企业,2019年公司北美运营商客户开发的多款产品均获得较高评价,有利于公司持续提升北美市场份额。

4、5G布局行业领先

2019年是5G开局之年,作为高通5G领航计划成员,公司在通讯终端业务板块率先布局了5G手机、5G平板电脑、5G电视、5G CPE、5G工业网关、5G IoT模块等众多产品,在半导体业务板块针对5G通信基础设施推出了高耐用的功率MOSFET和TVS保护器件产品;针对5G手机、笔电、IoT设备和汽车市场

商,研发中心和分布在上海、无锡、深圳、西安等地,制造基地分布在嘉兴、无锡、昆明、印度和印尼。

根据Omdia的《2020手机ODM产业白皮书》,2019年中国手机ODM厂商手机整体出货3.25亿部,同比小幅增长。其中,闻泰科技智能机出货达到1.1亿部,同比增长22%,智能机出货继续领先,华勤智能机出货达到8,500万部,龙旗2019年智能机出货7,340万部。闻泰科技手机ODM出货量处于行业领先地位。除手机外,公司目前移动终端业务板块也包括平板电脑、笔电、IoT模块、CPE、工业网关、TWS耳机等产品线。

2、半导体板块

发行人子公司安世集团是全球领先的标准器件半导体IDM企业,前身是半导体巨头恩智浦(NXP)的标准产品事业部,拥有60多年的半导体行业专业经验,其主要产品为分立器、逻辑器件和MOSFET器件,是一家集设计、制造、封装测试为一体的半导体跨国公司。安世集团三大业务均位于全球领先地位,其产品广泛应用于汽车、通信、工业控制、计算机、消费电子等领域。凭借丰富的车规级产品线与立足中国市场的优势,安世集团在2020年相继与大客户签订了战略合作协议,并于2021年第一季度跻身全球第九大功率半导体公司,相比2019年上升两位,并稳居国内功率半导体公司第一名。

关于分立器业务,安世集团主要产品包括各类小信号和中等功率产品组合,基础静电释放保护器件、低电压肖特基二极管、低电压晶体管等。安世集团拥有广泛的低成本、量产产品组合,其小信号二极管、小信号晶体管及ESD保护器件产品在全球市场的占有率位列第一。

关于逻辑器件业务,安世集团在微型逻辑和标准逻辑领域的产品组合丰富,0.7~18伏供电电压范围的逻辑技术处于领先地位,特别是在汽车工业客户群广泛,其逻辑器件产品在全球市场的占有率排名第二。

关于MOSFET器件业务,安世集团产品范围涵盖30~100伏各种高可靠性沟道MOSFET工艺,中、低EMOSFET产品组合领先,在汽车、电源、电信设备、服务器等严苛环境的高可靠性需求应用领域有丰富的客户设计订单,其小信号MOSFET器件在全球市场的占有率排名第二。

基于IHS 2019、2020行业数据及安世集团管理层提供的测算数据,在分立器业务、ESD保护器件、逻辑器件和MOSFET器件主要产品的全球市场占有率排名如下:

排名	双极晶体管/二极管/ESD保护器件	ESD保护器件	逻辑器件	小信号MOSFET器件	车用功率MOSFET器件
1	安世集团	安世集团	TI	ON Semi	Infineon
2	ON Semi	ON Semi	安世集团	安世集团	安世集团
3	Robm	ST	ON Semi	Robm	ON Semi

注:双极晶体管/二极管、ESD保护器件及小信号MOSFET器件排名引自IHS 2020行业数据,ESD保护器件排名引自IHS 2019行业数据,车用功率MOSFET器件排名来自安世集团管理层测算数据。

(三)公司竞争优势

1、通讯和半导体业务协同效应

2019年公司完成对安世集团控制权的收购,打通产业链上游和中游,形成从半导体产品设计、晶圆制造、半导体封装测试到终端产品研发设计、生产制造于一体的产业平台。

公司移动终端业务和半导体业务拥有较强的协同效应,业务和客户资源方面,公司移动终端业务积极采用半导体业务板块的器件,并依托自身在消费电子领域的长期积累,协助公司半导体业务拓展国内的消费电子半导体市场,进一步扩大公司半导体业务在国内的市场份额。公司也利用全资子公司安世集团拓展汽车电子领域的业务,在新能源汽车大规模替代燃油车、自动驾驶、无人驾驶等先进技术成熟前提前布局,技术方面,公司移动终端业务在智能终端ODM行业历经多年耕耘,对于高通芯片等芯片产品具有深刻的理解,具备智能终端功能模块的研发制造能力,全资子公司安世集团具有电子应用领域的标准器件生产能力和行业领先的封装技术。截至2021年4月30日,公司已推动包括5G射频频SIP模块、TWS主板模块、Watch主板模块等产品的研发,部分产品已经实现客户方案的Design In,公司移动终端业务和半导体业务优势互补、客户共享、资源互通,提升了公司整体的核心竞争力。

2、领先的第三代半导体技术

公司在2019年率先推出行业领先性能的第三代半导体氮化镓功率器件(GaN FET),目标市场包括电动汽车、数据中心、电信设备、工业自动化和高端电源,特别是在插电式混合动力汽车或纯电动汽车中,氮化镓技术是其使用的牵引逆变器的首选技术。由于硅氮化镓采用非常可靠耐用的工艺,是质量和可靠性久经考验的成熟技术,再加上其可以使用现有的硅晶圆加工设备,因此氮化镓工艺的扩展性很强,未来将根据客户需求灵活地进行扩产,有望帮助公司在该领域保持持续领先。目前,公司的650V氮化镓(GaN)技术已经通过车规级测试,将于2021年开始向汽车客户交付;碳化硅(SiC)产品目前已经实现了第一批晶圆和样品的交付。

3、半导体业务产能充足,设备制造能力突出

公司持续扩大半导体产能以满足市场不断增长的需求,助力实现安世集团的发展战略。前端曼彻斯特晶圆工厂正在进行8英寸产线的建设,第一阶段计划于2021年第三季度完成;同时,后端封测工厂也在同步进行改造升级,其中东莞工厂正在进行扩建,新增第4层厂房,并采用全新自动化产线和SIP(系统级封装)等新技术;同时,公司还通过投资来扩充菲律宾(LPFA)和马来西亚(夹片)的生产能。

公司位于荷兰的工业设备研发中心ITEC为安世集团保证了行业领先的产出效率和产品质量,ITEC成立于1991年,致力于成为半导体行业后端封测提供突破性的设备解决方案,主要负责公司半导体装配和测试设备的研发、更新改造及维护,并为大批量生产提供快速解决方案。ITEC与周边大学、科研机构及其其他半导体设备厂商如ASMIL等均有良好持久的合作关系,在人才交流、技术研发、专利互授等领域均有深度合作,使得ITEC保持其技术的持续领先地位。

4、产品品质深受市场认可

移动终端业务板块,公司秉持质量、进度、成本、交付四大工作原则,质量在所有工作中处于最高优先级。由于出色的质量水平,2019年公司为客户研发制造的众多产品均取得较好的销售成绩,特别是海外市场增长迅速,帮助公司业绩实现大幅增长。公司移动终端业务荣获多个产品质量奖项,产品质量长期可以得到客户的高度认可。

半导体业务板块,公司全资子公司安世集团作为世界领先的车规级功率器件厂商,其产品质量、供应体系具有全球领先地位,大部分产品均满足车规级认证标准;位于荷兰的工业设备研发中心ITEC为安世集团的核心竞争优势之一,进一步保证了安世集团行业领先的产出效率和产品质量,公司半导体业务荣获大陆集团“年度供应商”奖、博世全球供应商奖等诸多奖项,深受国际客户认可。

5、完善的全球交付体系

2019年公司移动终端业务板块先后建成并投产了印度制造基地、印尼制造基地、无锡封测基地。目前正在积极建设昆明封测基地,并进一步扩大海外生产基地,公司目前已实现全球接单当地交付,具备全球物料调遣、生产扩产的运作能力,可直接出口到欧美市场。公司还将会不断加大投入,扩大整机产线和注塑、喷涂等部件产能。

6、不断扩大的研发规模

通讯业务板块,研发团队规模快速扩大。上海、西安、无锡、嘉兴、深圳等研发中心均在持续引进大量优秀人才,以增强公司的研发能力。
 半导体业务板块,2020年公司新设了两个全球研发中心,分别位于马来西亚槟城和上海。其中马来西亚槟城研发中心为公司提供了进入模拟市场的强大切入点,并且多个模拟产品项目已经启动。上海研发中心专注于功率MOSFET,加速接口、模拟和电源管理领域的增长,并能够使得客户和本地合作伙伴更深入地参与研发,未来马来西亚槟城和中国上海研发中心将不断扩大规模,在进一步发现现有业务的同时拓展新的技术和市场。

7、持续开拓行业全球市场

移动终端板块,客户客户群遍及全球各地,与行业大多数主流品牌保持着深度的合作关系,服务全球170多个国家和地区。公司在2019年开始开拓海外市场,目前已在北美市场布局,打造全球交付体系并在海外建设生产基地,是行业少有的能满足北美运营商高标准的ODM企业,2019年公司北美运营商客户开发的多款产品均获得较高评价,有利于公司持续提升北美市场份额。

8、5G布局行业领先

2019年是5G开局之年,作为高通5G领航计划成员,公司在通讯终端业务板块率先布局了5G手机、5G平板电脑、5G电视、5G CPE、5G工业网关、5G IoT模块等众多产品,在半导体业务板块针对5G通信基础设施推出了高耐用的功率MOSFET和TVS保护器件产品;针对5G手机、笔电、IoT设备和汽车市场

提供一站式的二极管/晶体管、逻辑芯片、ESD防护MOSFET产品。另外公司还与中国移动联合推出“5G 终端先行者计划”,携手中国联通建立5G联合研发中心,与中国电信签订5G创新合作协议,帮助公司在5G领域迅速打开局面。

第五节 发行与承销

- 一、本次发行概况
- 1.发行数量:860,000.00万元(8,600万张,860万手)
- 2.向原股东发行的数量:向原股东优先配售4,787,563手,即4,787,563,000.00元,占本次发行总量的55.67%
- 3.发行价格:100元/张
- 4.可转换公司债券的面值:人民币100元/张
- 5.募集资金总额:人民币860,000.00万元
- 6.发行方式:本次发行的可转换公司债券向发行人于股权登记日(2021年7月27日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后备余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额全部由保荐机构(主承销商)包销。

7、配售结果

类别	认购数量(手)	认购金额(元)	配售数量/总发行量(%)
原A股股东	4,787,563	4,787,563,000.00	55.67
网上社会公众投资者	3,770,121	3,770,121,000.00	